

S6056

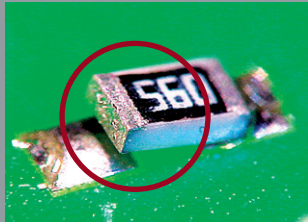
Extrem schnell und präzise –
High-End-AOI und High-End-3D-AOI



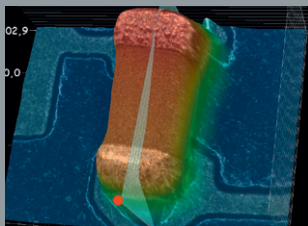
3D-AOI

Die zukunftssichere Inspektionslösung

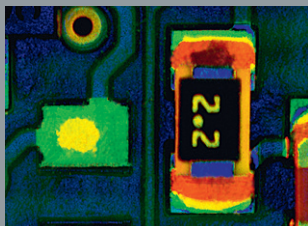
Schneller ... Optische Inspektion mit Hochleistungskamera



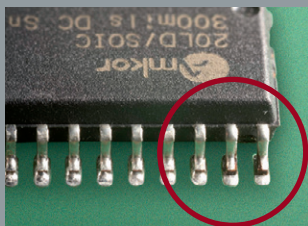
Chip-Tombstoning



Tombstone in der
3D-Ansicht



Sichere Klassifikation und
einfache Verifikation durch
farbige Beleuchtung



SOIC-Auflieger

**Skalierbare, modulare XM-Sensorik,
auch mit 3D-Funktion**

**Höchste Prüftiefe:
03015-Bauteile**

**Einzelspur- oder
Doppelspurbetrieb**

Leistungsstarke OCR-Software

**Schnelle Programmerstellung
mit vVision/EasyPro**

**Zusatzmodule:
Verifikation, Offline-Programmierung
und SPC-Auswertung**

**Weltweiter, kompetenter Service vor
Ort, Hotline und Fernwartung**

Schnelles, flexibles Handling

**Kunden-Support-Bereich
auf der Viscom-Website**

Bei der Fertigung elektronischer Baugruppen ist die Optimierung der Herstellungsprozesse ein wesentlicher Faktor, um hohen Qualitätsanforderungen und steigendem Preisdruck standzuhalten. Hier ist die Flexibilität und Leistungsfähigkeit der automatischen optischen Inspektion (AOI) entscheidend. Und das bedeutet: einfache Programmierung für schnelle Produktwechsel, hohe Prüftiefe, die auch noch künftigen Bauteilen gewachsen ist und hoher Durchsatz, der auch schnellen Taktraten gerecht werden kann.

Präziser...

Bessere Prüfergebnisse durch leistungsstarke XM-3D-Hochleistungssensorik



Mit der XM-Technologie ist Viscom ein **großer Schritt** in der **Entwicklung der Sensortechnologie** gelungen.

Mit einer Aufnahmerate von bis zu 1,8 Gigabit/s ist das neue XM-Modul von Viscom eines der **schnellsten AOI-Kamerasysteme** auf dem Markt. Die komplette Viscom-Eigenentwicklung vereint modernste Komponenten und **30 Jahre Erfahrung** in der Inspektionstechnologie.

Die **skalierbare modulare Sensorik** und die **vierfarbige Beleuchtung aus allen Raumrichtungen** schaffen für alle Fehler **optimale Kontraste** für die Merkmalsextraktion. So ist die S6056 auch für spezielle Prüfaufgaben, z. B. bei Schrift, Polungsmarken oder farbigen Bauelementen, bestens gerüstet. Um auch kleinste Bauteile sicher zu prüfen, kann mit der **OnDemandHR-Funktion** die optische Auflösung von 16 auf 8 μm (High Resolution) umgeschaltet werden.

Selbstverständlich verfügt das XM-Modul auch über die Viscom-typische Inspektion mit **geneigter Ansicht**. So werden auch kritische Fehler, z. B. Auflieger im Fine-Pitch-Bereich, zuverlässig detektiert. Eine vermehrte Nutzung der geneigten Ansicht, die Aufnahme zusätzlicher Bilder für den Verifikationsplatz oder weitere Beleuchtungen sind nahezu **taktzeitneutral**. Das erhöht die Prüftiefe und den **First Pass Yield**.

In der **3D-Funktion** werden bis zu neun Bildansichten aus unterschiedlichen Blickwinkeln mit Hilfe eines optionalen Streifenprojektors ausgewertet und **3D-Analysen im gesamten Bildfeld** realisiert. Damit ist insbesondere bei der Lifted-Lead- und der Chip-Auflieger-Prüfung sowie der IC-Koplanaritätsinspektion eine noch **exaktere Bewertung** möglich.

Technische Daten

S6056 ST1W		S6056 DS1W
Transportsystem	Einzelspur	Doppelspur
Prüfkonzept	Einzelprüfung	Einzelprüfung
Inspektionsumfang		
Lötstellen, Bestückung, Lotpaste		
Sensorik		
XM-3D-Sensorik		
Messbereich	Bis zu 30 mm	
Z-Auflösung	0,5 µm	
XM-Modul – Schrägansichtskameras		
Auflösung	16 µm (Standard)	
Anzahl der Megapixelkameras	4/8 (optional)	
XM-Modul – orthogonale Kamera		
Bildfeldgröße	40 mm x 40 mm	
Auflösung	16 µm (Standard), 8 µm (hoch) umschaltbar mit OnDemandHR	
Anzahl der Megapixelkameras	1	
XMplus-/8M-Sensorik (optional)		
Software		
Bedienoberfläche	Viscom vVision/EasyPro	Viscom EasyPro/vVision-ready
Verifikationsplatz	Viscom vVerify/HARAN	Viscom HARAN
SPC	Viscom SPC (statistische Prozesskontrolle), offene Schnittstelle (optional)	
Fernwartung	Viscom SRC (optional)	
Offline-Programmierung	Viscom PST34 (externe Programmierstation) (optional)	
Systemrechner		
Betriebssystem	Windows®	
Prozessor	Intel® Core™ i7	
Leiterplattenhandling		
Leiterplattengröße (L x B)	457 mm x 356 mm (Angaben der Ausführung DS1W, andere Größen optional)	
Leiterplattenstärke	1 - 5 mm (geringere Stärken optional)	
Übergabehöhe	850 - 960 mm ± 20 mm	
Breitenverstellung	Automatisch	
LP-Klemmung	Pneumatisch	
LP-Auflagebreite	3 mm	
Obere Durchfahrthöhe	50 mm	
Untere Durchfahrthöhe	40 mm (andere Höhen auf Anfrage)	
Prüfgeschwindigkeit		
Bis zu 65 cm²/s, minimierte Handlingzeit		
Sonstige Systemdaten		
Verfahr-/Positioniereinheit	Synchron-Linearmotoren	
Schnittstellen	SMEMA, SV70, kundenspezifisch	
Anschlusswerte	400 V (andere Spannungen auf Anfrage), 3P/N/PE, 8 A	
Systemmaße	1528 mm x 1650 mm x 1692 mm (B x H x T)	
Gewicht max.	1700 kg	

